

## Agenda zum Eltroplan Technologie-Tag 2009

### Herausforderungen und Lösungen für Elektronik-Design und -Produktion

Zeit	Thema	Referent
9:00 - 9:30	Registrierung	Birgit Haubner, Eltroplan GmbH
9:30 – 10:00	Eltroplan - das Smart Electronic Engineering and Manufacturing Service (SEEMS) Unternehmen Neue SMT-Linie von Eltroplan	Michael Pawellek, Eltroplan GmbH  Jörg Schüpbach, Juki Automation Systems AG
10:00 – 10:30	(Packaging-)Trends in der Elektronik	Gustl Keller, Eltroplan GmbH
10:30 – 11:00	RoHS, EuP und andere EU-Richtlinien	Bernhard Klee, ZVEI
11:00 – 11:30	Kaffeepause	
11:30 – 12:00	Design for „X“ - Herausforderungen und Beispiele	Axel Frank, Eltroplan GmbH
12:00 – 12:30	Spezielle Leiterplatten-Technologien	Hans-Jörg Etter, Optiprint AG
12:30 – 13:30	Mittagspause	
13:30 – 14:00	Fallstricke des Lötens	Dr. Hans Bell, Rehm Thermal Systems
14:00 – 14:30	Total Coverage-Prüfstrategien	Enrico Lusky, GÖPEL electronic GmbH
14:30 – 15:00	Kaffeepause	
15:00 – 15:30	Langzeit-Verfügbarkeit von Integrierten Schaltkreisen (Retro-iCs)	Dr. Heiner Flocke, iC-Haus
15:30 – 16:00	Schockfestigkeit elektronischer und mikromechanischer Systeme	Dr. Siegfried Nau, Fraunhofer EMI
16:00 – 16:30	Industrielle Computertomografie	Peter Ernst, Quality Analysis GmbH
16:30 – 17:00	Werksbesichtigung	Andreas Stephan/Bereich Engineering Peter Funke/Bereich Produktion